

(11) Publication number:

08293591 A

Generated Document

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 08033833

(51) Intl. Cl.: H01L 27/146 H01L 27/14 H04N 5/335

(22) Application date: 21.02.96

(30) Priority:

24.02.95 JP 07 60034

(43) Date of application

publication:

05.11.96

(84) Designated contracting states: (71) Applicant: NIKON CORP

(72) Inventor: KAMASHITA ATSUSHI SUZUKI SATOSHI **ISOGAI TADAO** 

(74) Representative:

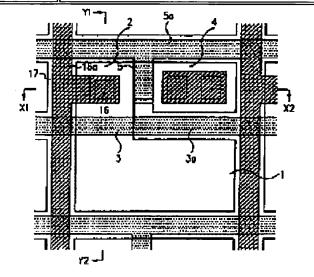
# (54) PHOTOELECTRIC **CONVERSION ELEMENT AND PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE**

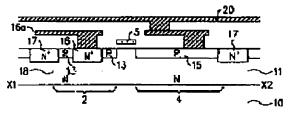
(57) Abstract:

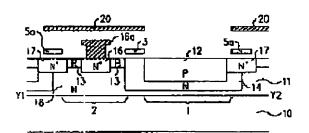
PURPOSE: To obtain a photoelectric conversion element which is capable of carrying out a reset operation without operating an amplifier and a photoelectric conversion device which is high in sensitivity (high S/N ratio) and low in power consumption.

CONSTITUTION: A photoelectric conversion element is equipped with a photodiode 1 which generates charge corresponding to an incident light and stores it, a junction field effect transistor(JFET) 2 which outputs signals corresponding to charge received by its control region, a transfer gate 3 which transfers charge generated and stored in the photodiode 1 to the control region of the JFET 2, a reset drain 4 which discharges charge transferred to the control region of the JFET 2, and a reset gate 5 which controls the reset drain 4, wherein a transfer gate wiring 3a, a reset gate wiring 5a, and a source wiring 16a are also provided.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO







## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平8-293591

(43)公開日 平成8年(1996)11月5日

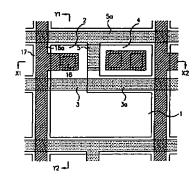
| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> | 識別記号         | <b>庁内整理番号</b>                     | FΙ         |                            | 技術表示箇所                 |        |          |
|---------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|--------|----------|
| H01L 27/146               |              |                                   | H01L 2     | 7/14                       | 4                      | A      |          |
| 27/14                     |              |                                   | H04N       | 5/335                      |                        | Z      |          |
| H 0 4 N 5/335             |              |                                   | H01L 27/14 |                            | D                      |        |          |
|                           |              |                                   | 審査請求       | 未請求                        | 請求項の数20                | OL     | (全 23 頁) |
| (21)出願番号                  | 特願平8-33833   |                                   | (71)出願人    |                            | 12<br>吐ニコン             |        |          |
| (22)出願日                   | 平成8年(1996)2月 | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号<br>(72)発明者 釜下 敦 |            |                            |                        |        |          |
| (31) 優先権主張番号<br>(32) 優先日  |              |                                   |            | 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株式会社ニコン内 |                        |        |          |
| (33) 優先権主張国               |              | (72)発明者                           | *****      |                            |                        |        |          |
|                           |              |                                   | (72)発明者    | 磯貝                         | ニコン内<br>忠男<br>千代田区丸の内: | 3 丁目 : | 2番3号 株   |

# (54) 【発明の名称】 光電変換素子及び光電変換装置

## (57)【要約】

【課題】 増幅部を動作させることなくリセット動作を行なうことができる光電変換素子及び高感度(高S/N比)で消費電力の少ない光電変換装置を得ることを目的とする。

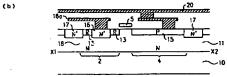
【解決手段】 光電変換素子は、入射光に応じた電荷を生成して蓄積するフォトダイオード1と、制御領域に受け取った電荷に応じた信号を出力する接合型電界効果トランジスタ(JFET)2と、フォトダイオード1によって生成・蓄積された電荷をJFET2の制御領域へ転送するための転送ゲート3と、JFET2の制御領域へ転送された電荷を排出するためのリセットドレイン4と、リセットドレイン4を制御するためのリセットゲート5とを備えている。また、転送ゲート配線3a、リセットゲート配線5a、及びソース配線16aも、図に示すように形成されている。

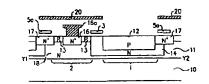


式会社ニコン内

(=)

(c)





### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 入射光に応じた電荷を生成して蓄積する 光電変換部と、

制御領域を有しこの制御領域で受け取った上記光電変換部からの電荷に応じた信号出力を生じる増幅部と、

上記光電変換部で生成、蓄積された電荷を上記増幅部の 制御領域に転送する転送制御部と、

上記増幅部の制御領域に転送された電荷を排出するリセット用電荷排出手段と、

このリセット用電荷排出手段を制御するためのリセット 10 用制御手段とを備えたことを特徴とする光電変換素子。

【請求項2】 増幅部の制御領域を、容量結合によって制御する制御手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項3】 増幅部は、電界効果トランジスタからなることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項4】 光電変換部、増幅部、転送制御部、リセット用電荷排出手段、リセット用制御手段の各相互領域間に、予め定められた導電型の素子分離領域が形成されていることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。 【請求項5】 リセット用電荷排出手段に接続される金属配線は、増幅部、転送制御部、リセット用電荷排出手段、リセット用制御手段への入射光を遮断する遮光膜によって形成されていることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項6】 光電変換部は、縦形オーバーフロー構造のPN接合フォトダイオードであることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項7】 光電変換部は、縦形オーバーフロー構造の埋め込みフォトダイオードであることを特徴とする請 30 求項1記載の光電変換素子。

【請求項8】 増幅部は、接合型電界効果トランジスタからなり、この接合型電界効果トランジスタのチャネル形成部は、半導体表面から半導体基板内部に向かって順に、第1導電型ゲート領域、第2導電型チャネル領域、第1導電型半導体基板によって形成されていることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項9】 増幅部は、接合型電界効果トランジスタからなり、上記接合型電界効果トランジスタのチャネル形成部は、半導体表面から半導体基板内部に向かって順 40 に、浅い第1導電型ゲート領域、浅い第2導電型チャネル領域、第1導電型ゲート領域、第2導電型ウェル領域、及び第1導電型半導体基板によって形成されていることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項10】 増幅部は、接合型電界効果トランジスタからなり、上記接合型電界効果トランジスタのチャネル形成部は、半導体表面から半導体基板内部に向かって順に、浅い第1導電型ゲート領域、浅い第2導電型チャネル領域、第1導電型ゲート領域、第2導電型ウェル領域、及び第1導電型半導体基板によって形成され、上記 50

浅い第1導電型ゲート領域と上記第1導電型ゲート領域 とは、上記チャネル形成部以外の部分で電気的に導通さ れていることを特徴とする請求項1記載の光電変換素 子。

【請求項11】 光電変換部は、縦形オーバーフロー構造の埋め込みフォトダイオードであり、増幅部は、接合型電界効果トランジスタからなり、上記接合型電界効果トランジスタのチャネル形成部は、半導体表面から半導体基板内部に向かって順に、浅い第1導電型ゲート領域、第2導電型ウェル領域、及び第1導電型半導体基板によって形成され、上記浅い第1導電型ゲート領域と上記第1導電型ゲート領域とは、上記チャネル形成部以外の部分で電気的に導通されており、上記第1導電型ゲート領域の不純物濃度と上記埋め込みフォトダイオードの電荷蓄積部の不純物濃度とは異なることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項12】 第1導電型ゲート領域の不純物濃度は 6×10<sup>15</sup> c m<sup>-3</sup>~3×10<sup>16</sup> c m<sup>-3</sup>の範囲であり、埋 20 め込みフォトダイオードの電荷蓄積部の不純物濃度は5×10<sup>15</sup> c m<sup>-3</sup>~3×10<sup>16</sup> c m<sup>-3</sup>の範囲であることを 特徴とする請求項11記載の光電変換素子。

【請求項13】 増幅部は、MOS型電界効果トランジスタからなり、かつデブレッション型であることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項14】 増幅部は、バイポーラトランジスタからなり、このバイポーラトランジスタは、光電変換素子の周りを囲うようにシリコン表層部に形成された予め定められた導電型の高濃度領域をコレクタとしていることを特徴とする請求項1記載の光電変換素子。

【請求項15】 入射光に応じた電荷を生成して蓄積する光電変換部、制御領域を有しての制御領域で受け取った上記光電変換部からの電荷に応じた信号出力を生じる増幅部、上記光電変換部で生成、蓄積された電荷を上記増幅部の制御領域に転送する転送制御部、上記増幅部の制御領域に転送された電荷を排出するリセット用電荷排出手段、及びこのリセット用電荷排出手段を制御するためのリセット用制御手段を備えた光電変換素子を二次元マトリクス状に配置してなることを特徴とする光電変換装置。

【請求項16】 少なくとも1つの読出し方向に配列された各光電変換素子のリセット用電荷排出手段同士は、互いに並列に配設されていることを特徴とする請求項15記載の光電変換装置。

【請求項17】 垂直走査回路と、

パルス駆動源とをさらに備え、

全ての光電変換素子における転送制御部の転送用制御手 段とリセット用電荷排出手段とが、それぞれ水平読出し 方向に共通接続されてパルス駆動のための上記垂直走査 回路に接続され、

3

全ての光電変換素子のリセット用制御手段が、共通に上記パルス駆動源に接続されていることを特徴とする請求項15記載の光電変換装置。

【請求項18】 垂直走査回路と、

パルス駆動源と、

電源とをさらに備え、

全ての光電変換素子における転送制御部の転送用制御手段と増幅部の制御領域を容量結合によって制御する制御手段とが、それぞれ水平読出し方向に共通接続されてパルス駆動のための上記垂直走査回路に接続され、

全ての光電変換素子におけるリセット用制御手段とリセット用電荷排出手段とが、それぞれ共通接続されて、上記リセット用制御手段が上記パルス駆動源に、上記リセット用電荷排出手段が上記電源に接続されていることを特徴とする請求項15記載の光電変換装置。

【請求項19】 垂直走査回路と、 パルス駆動源と、

電源とをさらに備え、

全ての光電変換素子における増幅部の制御領域を容量結合によって制御するための制御手段とリセット用制御手段とが、それぞれ水平読出し方向に共通接続されてバルス駆動のための上記垂直走査回路に接続され、

全ての光電変換素子における転送制御部の転送用制御手段とリセット用電荷排出手段とがそれぞれ共通接続されて、上記転送用制御手段が上記パルス駆動源に、上記リセット用電荷排出手段が上記電源に接続されていることを特徴とする請求項15記載の光電変換装置。

【請求項20】 各光電変換素子を水平読出し方向に共通駆動する垂直走査回路と、

垂直走査に応じて上記増幅部の制御領域が初期化された 30 直後の1水平ライン分の信号出力を記憶する第1の記憶 手段と、

垂直走査に応じて上記増幅部の制御領域へ上記電荷を転送した直後の1水平ライン分の信号出力を記憶する第2の記憶手段とをさらに備えたことを特徴とする請求項15記載の光電変換装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光電変換素子及び光電変換装置、特に、増幅部を動作させることなくリセット 40動作を行なうことができる光電変換素子及びリセット動作が高速な光電変換装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より光電変換装置(固体撮像装置等 により過渡的にトランジスタのバイアスを含む)の感度を高めるために提案されているトランジ 大きく変動して増幅率が変わるという問えるを利用した増幅型の光電変換素子には、MOS型 そして、このような光電変換素子を多数 光電変換装置を構成した場合には、光電変換装置を構成した場合には、光電変換素子の単成要 力にばらつきが生じ、装置の性能(例えて、これらの光電変換素子では、光電変換素子の構成要 が低下したり、多数個配列しているため、素の一部であるMOSダイオード(MOS型)やPN接 50 くなってしまうという問題点もあった。

合ダイオード(バイポーラ型、JFET型)への入射光 を、入射光に応じた電荷に光電変換して蓄積し、蓄積し た電荷に応じた信号を増幅(電流増幅あるいは電荷増 幅)して、出力している。

【0003】上記のような光電変換素子には、光電変換動作、増幅動作、初期化動作等の全ての動作を1つのトランジスタによって行う光電変換素子(即ち、光電変換素子を1つのトランジスタによって構成した光電変換素子)があるが、との光電変換素子には、2つの大きな問題点がある。なお、ここで、初期化動作とは、トランジスタの制御領域の電位をある基準値に設定する動作、又は制御領域を完全に空乏化する動作をいう。また、トランジスタの制御領域とは、電流を制御する領域をいい、例えばJFETではゲート拡散領域、バイボーラトランジスタではベース拡散領域をいう。

【0004】先ず、第1の問題点としては、光電変換部のノイズが大きくなってしまう点である。例えば、MO S型の場合、通常ポリシリコンをゲート電極としたMO Sダイオードで光電変換を行うが、その際に、シリコン表面側が空乏化するため、その表面で発生する大きな暗電流の影響をまともに受けてしまい、ノイズが大きくなってしまうのである。また、ポリシリコンは光の透過率が低いため、光の利用効率(量子効率)が悪いという問題点もあった。

【0005】PN接合ダイオードで光電変換を行うバイボーラ型や、JFET型の場合でも、上記トランジスタの構成要素の一部を利用するという制約から、CCD型撮像素子等で好適に使われている埋め込みフォトダイオードのような理想的なダイオード構造が実現できない(即ち、バイボーラ型、JFET型の場合には、PN接合部から発生する空乏層が表面に達してしまう)ため、暗電流の影響を受けてしまい、ノイズが大きくなってしまうのである。

【0006】また、通常とれらのPN接合ダイオードは、容量結合による過渡的でかなり深い順方向バイアス駆動によって、生成して蓄積した電荷を再結合させてリセット動作を行うが、このようなリセット方法では、リセットノイズや残像が発生してしまうという問題点が生じる。

【0007】さらに、生成して蓄積した電荷をリセットする時、およびブルーミング(にじみ)抑圧動作をする時にもトランジスタが動作(オン)するため、光電変換素子を構成するトランジスタ自身に大電流が流れ、これにより過渡的にトランジスタのバイアス点(動作点)が大きく変動して増幅率が変わるという問題点があった。そして、このような光電変換素子を多数並べて、例えば光電変換装置を構成した場合には、光電変換素子毎の出力にばらつきが生じ、装置の性能(例えば、S/N比)が低下したり、多数個配列しているため消費電力が大きくなってしまうという問題点もあった。

【0008】次に、第2の問題点としては、感度をあま り高くすることができない点である。そもそも、上記各 種(MOS型、バイポーラ型、JFET型)のトランジ スタ(光電変換素子)は、光電変換によって生成された 電荷をフローティング状態の制御領域に蓄積することに よって生ずる電位変化を利用して、電流増幅又は電荷増 幅を行っている。つまり、デプレッション型のMOS型 トランジスタであればゲート電極下のシリコンの表面電 位の変化、バイポーラ型ではベース領域、JFET型で はゲート領域の電位変化を利用して増幅した出力を得て 10

【0009】従って、高い感度を得るためには、この電 位変化量(蓄積電荷量/容量)を大きくすることが必要 であり、そのためには制御領域の容量はできるだけ小さ い方が良い。しかしながら、入射光の利用効率を高め、 電荷量を増加させるためには、光電変換部の面積(受光 開口率)を大きくしなければならない。しかし、全ての 動作(光電変換動作、増幅動作、初期化動作等)を1つ のトランジスタで行う光電変換素子においては、制御領 域が光電変換部そのものであるため、開口率を大きくす れば容量も大きくなってしまい、結果的に感度をあまり 高くすることができなかった。

【0010】また、他方において、光電変換部と増幅ト ランジスタとを分離し、光電変換部で生成・蓄積された 電荷を転送制御部の転送ゲートを介してトランジスタの 制御領域に転送し、電流増幅あるいは電荷増幅をするこ とにより出力を得る光電変換素子が提唱されている。例 えば、特開平5-235317号公報(米国特許出願第 261, 135号に対応)、特開平5-275670号 公報には、それぞれ、デプレッション型MOSトランジ 30 スタやJFETを増幅部として、これにフォトダイオー ドと転送制御部(転送ゲート)を組み合わせた光電変換 素子が開示されている。

【0011】このように光電変換部と増幅トランジスタ とを分離し転送ゲートを備えた光電変換素子において は、光電変換部に埋め込みフォトダイオードを使用する ことによって、量子効率が高く、残像、暗電流、リセッ トノイズなどが発生しない光電変換素子を実現すること ができる。

【0012】また、光電変換部に縦型オーバーフロー構 40 造の埋め込みフォトダイオードを使用した場合は、フォ トダイオードがブルーミング抑圧機能を有するため、増 幅トランジスタによるブルーミング抑圧動作が不要とな り、例えば光電変換装置を構成しても、消費電力の増加 やバイアス点(動作点)の変動に伴う光電変換素子毎の 出力にばらつきが生じるという問題点が解決される。

【0013】さらに、光電変換部と増幅トランジスタと が分離しているため、増幅機能のみを考慮して、トラン ジスタの構造及びサイズの最適化が可能となる。従っ て、制御領域の容量を小さくして、高い感度を確保する 50 であり、装置の性能(例えば、S/N比)が低下した

ととができる。加えて、トランジスタ自身から生ずる暗 電流、残像、リセットノイズ等の新たな問題について は、これらの光電変換素子をマトリクス状に並べた光電 変換装置の構成や駆動方法でかなり効果的に除去すると

【0014】このように、光電変換部と増幅トランジス タとを分離し転送ゲートを備えた光電変換素子において は、トランジスタによって全ての動作(光電変換動作、 増幅動作、初期化動作等)を行う光電変換素子に比べ て、かなり低ノイズ化、高感度化することが可能になっ

[0015]

とができる。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来の光電変換素子(光電変換部と増幅トランジスタとを 分離し転送ゲートを備えた光電変換素子)においては、 1つのトランジスタによって全ての動作を行うもう一方 の従来の光電変換素子とリセット動作については何ら変 わっていないという問題点があった。

【0016】即ち、トランジスタの制御領域を初期化を するためにリセット動作を行った場合、従来の光電変換 素子(光電変換部と増幅トランジスタとを分離し転送ゲ ートを備えた光電変換素子)では、やはり、増幅トラン ジスタ自身も同時に動作(オン)してしまうという問題 点があった。

【0017】この結果、増幅トランジスタに大電流が流 れ、これにより過渡的に増幅トランジスタのバイアス点 (動作点)が大きく変動して増幅率が変わり、この光電 変換素子を多数並べて、例えば光電変換装置を構成した 場合には、光電変換素子毎の出力にばらつきが生じ、装 置の性能 (例えば、S/N比) が低下したり、多数個配 列しているため消費電力が大きくなってしまうという問 題点があった。

【0018】本発明は、上記課題を鑑みて成されたもの であり、増幅部を動作させることなく、リセット動作を 行うことができる光電変換素子を得ることを目的とす る。また、本発明の別の目的は、固定パターンノイズの 発生を抑制することができる光電変換素子を得ることで

【0019】さらに、本発明の別の目的は、開口率や集 積度を向上させることができる光電変換素子を得ること である。また、本発明の別の目的は、斜め入射光による ブルーミング等のにじみの現象を抑制することができる 光電変換素子を得ることである。

【0020】また、本発明の別の目的は、暗電流や残 像、リセットノイズを抑制した理想的な特性を得ること ができる光電変換素子を得ることである。また、本発明 の別の目的は、感度を高くすることができる光電変換素 子を得ることである。

【0021】本発明は、上記課題を鑑みてなされたもの

り、消費電力が増大したりすることを抑制することができる光電変換装置を得ることを目的とする。また、本発明の別の目的は、リセット動作が高速な光電変換装置を得ることである。さらに、本発明の別の目的は、電荷成分のみに応じた信号出力を得ることができる光電変換装置を得ることである。

#### [0022]

【課題を解決するための手段】本発明のうち請求項1記載の発明は、入射光に応じた電荷を生成して蓄積する光電変換部と、制御領域を有しこの制御領域で受け取った 10上記光電変換部からの電荷に応じた信号出力を生じる増幅部と、上記光電変換部で生成、蓄積された電荷を上記増幅部の制御領域に転送する転送制御部と、上記増幅部の制御領域に転送された電荷を排出するリセット用電荷排出手段と、このリセット用電荷排出手段を制御するためのリセット用制御手段とを備えたことを特徴とする光電変換素子である。

【0023】ここで、光電変換部は、入射光に応じた電荷を生成して蓄積する。増幅部は、制御領域で受け取った上記電荷に応じて信号出力を生じる。転送制御部は、上記光電変換部で生成・蓄積された電荷を上記増幅部の制御領域へ転送する。リセット用電荷排出手段は、上記増幅部の制御領域へ転送された電荷を排出する。リセット用制御手段は、上記リセット用電荷排出手段を制御する。

【0024】つまり、従来の光電変換素子では、増幅部の制御領域を初期化(制御領域に残留する電荷(信号電荷)を除去)するためにリセット動作を行った場合、増幅部自身も動作(オン)していたため、例えば、増幅部自身に大電流が流れ、これにより過渡的に増幅部のバイ 30アス点(動作点)が大きく変動して増幅率が変わるという問題点が発生していた。

【0025】そこで、本発明においては、増幅部の制御領域を初期化するためのリセット用電荷排出手段とリセット用制御手段とを増幅部とは別個独立に設けることにより、リセット動作時において増幅部が動作しないようになる。従って、従来の光電変換素子のように、リセット動作によって、増幅部自身に大電流が流れ、これに伴って過渡的に増幅部のバイアス点(動作点)が大きく変動して増幅率が変わるという問題点が解消される。

【0026】なお、一般的に、上記増幅部には、増幅部の制御領域を容量結合によって制御するための制御手段が備えられる場合が多い。しかし、この制御手段を備えない場合には、この制御手段への配線が不要となり、製造が容易になるとともに、制御手段を備えない分だけ、増幅部の制御領域の容量を小さくすることができ、感度を高くすることが可能となる。

【0027】請求項2記載の発明は、請求項1記載の光 電変換素子に、増幅部の制御領域を容量結合によって制 御する制御手段をさらに備えたものである。即ち、光電 50

変換素子の増幅部には、該増幅部の制御領域を容量結合によって制御するための制御手段が備えられる場合が多い。従って、上記制御手段を備えた光電変換素子でも、増幅部の制御領域を初期化するためのリセット用電荷排出手段とリセット用制御手段とを増幅部とは別個独立に設けることにより、リセット動作時において増幅部が動作しないようになる。従って、従来の光電変換素子のように、リセット動作によって、増幅部自身に大電流が流れ、これにより過渡的に増幅部のバイアス点(動作点)が大きく変動して増幅率が変わるという問題点が解消さ

【0028】請求項3記載の発明は、請求項1記載の光電変換素子における増幅部を、電界効果トランジスタ(FET)によって構成するものである。即ち、上記増幅部は、信号(電荷)破壊に基づく固定パターンノイズの発生を抑制するものによって構成することが好ましい。このためには、上記光電変換部によって生成・蓄積された電荷(信号電荷)を非破壊で増幅する電界効果トランジスタ(FET)によって構成することが好ましい。

【0029】請求項4記載の発明は、請求項1記載の光電変換素子における光電変換部、増幅部、転送制御部、リセット用電荷排出手段、リセット用制御手段の各相互領域間に、予め定められた導電型の素子分離領域を形成したものである。つまり、上記光電変換部、増幅部、転送制御部、リセット用電荷排出手段、リセット用制御手段の各相互領域の間隙は、一般的に、開口率や集積度の観点からできるだけ小さくすることが望まれているが、光電変換素子の製造工程においては、ドーパント(不純物)の所謂サイド拡散の影響を受けるため、各相互領域の間隙を小さくすることが困難である。

【0030】従って、上記光電変換部、増幅部、転送制御部、リセット用電荷排出手段、リセット用制御手段の各相互領域間に、予め定められた導電型の素子分離領域を形成し、上記各相互領域の間隙をできるだけ小さくすることにより、開口率や集積度を向上させることが可能になる。

【0031】請求項5記載の発明は、請求項1記載の光電変換素子におけるリセット用電荷排出手段に接続される金属配線を、上記増幅部、転送制御部、リセット用電荷排出手段、リセット用制御手段への入射光を遮断する遮光膜によって形成したものである。つまり、金属配線が遮光膜を兼用する。従って、入射光を遮断するための遮光膜を形成する必要がなくなり、光電変換素子全体の厚みを薄くすることが可能になって集積度を向上させることが可能になるとともに、上記光電変換部近傍に上記金属配線兼遮光膜を配設することが可能になり、斜め入射光によるブルーミング等のにじみの現象を抑制することが可能になる。

【0032】請求項6記載の発明は、請求項1の光電変

در دیا 20

導電型チャネル領域、第1導電型ゲート領域、第2導電 型ウェル領域、第1導電型半導体基板によって形成され ている。

換素子における光電変換部を、縦形オーバーフロー構造 のPN接合フォトダイオードによって構成したものであ る。即ち、増幅部とは別個独立のリセット用電荷排出手 段とリセット用制御手段とを設けた光電変換素子におい ても、光電変換部を縦形オーバーフロー構造のPN接合 フォトダイオードによって構成することが可能であり、 光電変換部を縦形オーバーフロー構造のPN接合フォト ダイオードで構成することによって、ブルーミングやス ミア等のにじみ現象を抑制することが可能になる。

【0038】つまり、浅い第1導電型ゲート領域と浅い 第2 導電型チャネル領域によってチャネル形成部分がシ ャロー化(浅接合化)して、この接合型電界効果トラン ジスタ全体を縮小化するとともに、第1導電型ゲート領 域と第1導電型半導体基板との間隙に第2導電型ウェル 領域を介在させることによって、上記第1導電型ゲート 領域と第1導電型半導体基板とが電気的に分離される。 【0039】従って、シャロー化により相互コンダクタ ンスが向上し、また縮小化した分だけ集積度や開口率が 向上するとともに、感度を高くすることが可能になる。 また、接合型電界効果トランジスタ(JFET)のゲー ト (制御領域) と半導体基板とを電気的に分離すること により基板電圧の影響(基板バイアス効果)を抑えて、 電流増幅動作時の増幅率や、ソースフォロワ動作時の電

【0033】請求項7記載の発明は、請求項1記載の光 10 電変換素子における光電変換部を、縦形オーバーフロー 構造の埋め込みフォトダイオードによって構成したもの である。即ち、増幅部とは別個独立のリセット用電荷排 出手段とリセット用制御手段とを設けた光電変換素子に おいても、光電変換部を縦形オーバーフロー構造の埋め 込みフォトダイオードによって構成することが可能であ り、光電変換部を縦形オーバーフロー構造の埋め込みフ ォトダイオードによって構成することによって、ブルー ミングやスミア等のにじみ現象のほか、暗電流や残像、 リセットノイズを抑制した理想的な特性を得ることが可 20 能になる。

【0040】請求項10記載の発明は、請求項1記載の 光電変換素子における増幅部を、接合型電界効果トラン ジスタ (JFET) によって構成し、上記接合型電界効 果トランジスタ(JFET)のチャネル形成部は、半導 体表面から半導体基板内部に向かって順に、浅い第1導 電型ゲート領域、浅い第2導電型チャネル領域、第1導 電型ゲート領域、第2導電型ウェル領域、第1導電型半 導体基板によって形成され、上記浅い第1導電型ゲート 領域と上記第1導電型ゲート領域とは、チャネル形成部 以外の部分で電気的に導通されている。

荷増幅率を向上することが可能になる。

【0034】請求項8記載の発明は、請求項1記載の光 電変換素子における増幅部を、接合型電界効果トランジ スタ(JFET)によって構成し、上記接合型電界効果 トランジスタのチャネル形成部を、半導体表面から半導 体基板内部に向かって順に、第1導電型ゲート領域、第 2 導電型チャネル領域、第1 導電型半導体基板によって 形成したものである。

> 【0041】即ち、光電変換素子の増幅部としては、接 合型電界効果トランジスタ (JFET) によって構成し 30 てもよく、との接合型電界効果トランジスタ(JFE T) のチャネル形成部を半導体表面から半導体基板内部 に向かって順に、浅い第1導電型ゲート領域、浅い第2 導電型チャネル領域、第1導電型ゲート領域、第2導電 型ウェル領域、第1導電型半導体基板によって形成さ れ、上記浅い第1導電型ゲート領域と上記第1導電型ゲ ート領域とは、チャネル形成部以外の部分で電気的に導 通されている。

【0035】即ち、光電変換素子の増幅部としては、接 合型電界効果トランジスタ(JFET)によって構成し てもよく、この接合型電界効果トランジスタ(JFE T) のチャネル形成部を半導体表面から半導体基板内部 に向かって順に、第1導電型ゲート領域、第2導電型チ ャネル領域、第1導電型半導体基板としてもよい。従っ て、電荷(信号電荷)を増幅時には、第1導電型ゲート 領域及び第2導電型チャネル領域を介して上記電荷(信 号電荷)が増幅される。

> 【0042】従って、シャロー化により相互コンダクタ ンスが向上し、また縮小化した分だけ集積度や開口率が 向上するとともに、感度を高くすることが可能になる。 また、上記浅い第1導電型ゲート領域と第1導電型ゲー ト領域とを導通し、接合型電界効果トランジスタ(JF ET)のゲート(制御領域)と半導体基板とを電気的に 分離することにより基板電圧の影響(基板バイアス効 果)を大幅に抑えて、電流増幅動作時の増幅率や、ソー スフォロワ動作時の電荷増幅率を向上することが可能と

【0036】請求項9記載の発明は、請求項1記載の光 電変換素子における増幅部を、接合型電界効果トランジ スタ(JFET)によって構成し、上記接合型電界効果 40 トランジスタ (JFET) のチャネル形成部は、半導体 表面から半導体基板内部に向かって順に、浅い第1導電 型ゲート領域、浅い第2導電型チャネル領域、第1導電 型ゲート領域、第2導電型ウェル領域、第1導電型半導 体基板によって形成したものである。

【0043】請求項11記載の発明は、請求項1記載の

【0037】即ち、光電変換素子の増幅部としては、接 合型電界効果トランジスタ(JFET)によって構成し てもよく、この接合型電界効果トランジスタ(JFE T)のチャネル形成部を半導体表面から半導体基板内部 に向かって順に、浅い第1導電型ゲート領域、浅い第2 50 光電変換素子における光電変換部を縦形オーバーフロー

構造の埋め込みフォトダイオードとし、増幅部を、接合 型電界効果トランジスタとし、上記接合型電界効果トラ ンジスタのチャネル形成部は、半導体表面から半導体基 板内部に向かって順に、浅い第1導電型ゲート領域、浅 い第2導電型チャネル領域、第1導電型ゲート領域、第 2導電型ウェル領域、及び第1導電型半導体基板によっ て形成され、上記浅い第1導電型ゲート領域と上記第1 導電型ゲート領域とは、チャネル形成部以外の部分で電 気的に導通されており、上記第1導電型ゲート領域の不 純物濃度と上記埋め込みフォトダイオードの電荷蓄積部 10 の不純物濃度とは異なることを特徴とする。これによっ て、埋め込みフォトダイオードと接合型電界効果トラン ジスタとを好適な条件で動作させることが可能となる。 【0044】請求項12記載の発明は、請求項11記載 の光電変換素子における第1導電型ゲート領域の不純物 濃度を6×101'cm-3~3×101'cm-3の範囲と し、埋め込みフォトダイオードの電荷蓄積部の不純物濃 度は5×101'cm-3~3×101'cm-3の範囲とす る。これによって、埋め込みフォトダイオードと接合型 電界効果トランジスタとを最適な条件で動作させること 20 が可能となる。

【0045】請求項13記載の発明は、請求項1記載の光電変換素子における増幅部を、デプレッション型のMOS型電界効果トランジスタによって構成したものである。従って、信号(電荷)破壊に基づく固定パターンノイズの発生を抑制することが可能になる。また、MOS型電界効果トランジスタは制御領域のリセット動作時にリセットノイズや残像が発生しないため、電子シャッター動作を可能とする光電変換素子を構成する場合に好適である。

【0046】請求項14記載の発明は、請求項1記載の 光電変換素子における増幅部を、バイボーラトランジス タによって構成し、このバイポーラトランジスタは、埋 め込みコレクタ又は予め定められた導電型の高濃度基板 を用いたコレクタを形成することなく、光電変換素子の 周りを囲うようにシリコン表層部に形成された予め定め られた導電型の髙濃度領域をコレクタとしている。従っ て、バイポーラトランジスタと縦形オーバーフロー構造 のフォトダイオードの組合せが可能となり、ブルーミン グやスミア等の偽信号を抑制することが可能になる。 【0047】請求項15記載の発明は、入射光に応じた 電荷を生成して蓄積する光電変換部、制御領域を有して の制御領域で受け取った上記光電変換部からの電荷に応 じた信号出力を生じる増幅部、上記光電変換部で生成、 蓄積された電荷を上記増幅部の制御領域に転送する転送 制御部、上記増幅部の制御領域に転送された電荷を排出 するリセット用電荷排出手段、及びこのリセット用電荷 排出手段を制御するためのリセット用制御手段を備えた 光電変換素子を二次元マトリクス状に配置してなること を特徴とする光電変換装置である。

17

【0048】請求項16記載の発明は、請求項15記載の光電変換装置において、少なくとも1つの方向、例えば水平読出し方向に配列された各光電変換素子のリセット用電荷排出手段同士が、互いに並列に配設されていることを特徴とする。つまり、水平読出し方向に配列された各光電変換素子のリセット用電荷排出手段同士を互いに並列に配設することによって、光電変換素子の単位画素内において、必ず増幅部とリセット部とが対応することとなり、極めて短時間で増幅部の制御領域をリセット部の電位に初期化することが可能になる。即ち、リセット動作を高速にすることが可能となる。

【0049】請求項17記載の発明は、請求項15記載の光電変換装置に、垂直走査回路と、バルス駆動源とをさらに備え、全ての光電変換素子における転送制御部の転送用制御手段とリセット用電荷排出手段とが、それぞれ水平読出し方向に共通接続されてバルス駆動のための上記垂直走査回路に接続され、全ての光電変換素子のリセット用制御手段が、共通に上記バルス駆動源に接続されていることを特徴とする。

【0050】つまり、上記のように構成された光電変換装置においては、先ず、垂直走査回路によってある特定の水平ライン(選択行)のリセット用電荷排出手段にハイレベルの電圧が印加され、他の水平ライン(非選択行)のリセット用電荷排出手段にはローレベルの電圧が印加される。次いで、全てのリセット用制御手段にパルス駆動源より駆動パルスが印加される。

【0051】との結果、選択行の光電変換素子に備えられた増幅部の制御領域がハイレベルの電圧に、非選択行の光電変換素子に備えられた増幅部の制御領域はローレベルの電圧に初期化される。このように、増幅部の制御領域の初期化動作をリセット用電荷排出手段とリセット用制御手段とによって行うことにより、従来の光電変換装置のように、増幅部の制御領域を順方向バイアス駆動して電荷(信号電荷)を再結合するリセット動作を行う必要がない。

【0052】従って、増幅部に大電流が流れ、光電変換素子を多数個並べて光電変換装置を構成した場合、過渡的に増幅部のバイアス点(動作点)が大きく変動して増幅率が変わり、各光電変換素子毎の出力にばらつきが生じ、装置の性能(例えば、S/N比)が低下したり、消費電力が大きくなってしまうという問題点を解消することが可能になる。

【0053】なお、増幅部の制御領域が初期化された後は、垂直走査回路から送出される駆動バルスが上記光電変換素子に備えられた転送用制御手段に印加される。この結果、上記光電変換素子に備えられた光電変換部で生成・蓄積された電荷(信号電荷)が、上記光電変換部から上記増幅部の制御領域へ転送され、該増幅部において電荷(信号電荷)の増幅動作が行われる。

50 【0054】請求項18記載の発明は、請求項15記載

の光電変換装置に、垂直走査回路と、バルス駆動源と、 電源とをさらに備え、全ての光電変換素子における転送 制御部の転送用制御手段と増幅部の制御領域を容量結合 によって制御する制御手段とが、それぞれ水平読出し方 向に共通接続されてバルス駆動のための上記垂直走査回 路に接続され、全ての光電変換素子におけるリセット用 制御手段とリセット用電荷排出手段とが、それぞれ共通 接続されて、上記リセット用制御手段が上記バルス駆動 源に、上記リセット用電荷排出手段が上記電源に接続さ れていることを特徴とする。

【0055】つまり、本発明の特徴を従来の最も一般的な光電変換装置の構成に適用した場合には、上記の構成となる。即ち、本発明の特徴は、増幅部を動作させることなく、増幅部の制御領域を初期化するために、上記増幅部に対して独立別個のリセット用電荷排出手段とリセット用制御手段を設け、さらに、リセット動作の高速化を図るため、水平読出し方向に配列された各光電変換素子の上記リセット用電荷排出手段同士を互いに並列に配設している点である。従って、上記のような構成にすることによって、従来の光電変換装置の構成をほとんど変えることなく、光電変換装置を製造することが可能となる。従って、容易に製造することが可能となる。従って、容易に製造することが可能となる。

【0056】また、上記のように構成された光電変換装置においては、リセット用電荷排出手段は、電源から固定的に電圧が供給されるようになっており、供給された電圧を増幅部の制御領域へ供給する。また、リセット用制御手段は、パルス駆動源から送出される駆動パルスに応じて動作(オン、オフ)する。ことで、上記リセット用制御手段の動作(オン、オフ)は、リセット用電荷排出手段から増幅部の制御領域へ供給される電圧を制御する。

【0057】即ち、リセット用制御手段の動作(オン,オフ)に応じて、リセット用電荷排出手段から増幅部の制御領域に電圧が供給されるのである。そして、増幅部の制御領域に供給された電圧によって、増幅部の制御領域がリセット用電荷排出手段の電位と同電位にされ、増幅部の制御領域が初期化される。

【0058】従って、増幅部の初期化動作時に、増幅部が動作(オン)しないため、増幅部に大電流が流れ、これにより過渡的に増幅部のバイアス点(動作点)が大きく変動して増幅率が変わり、各光電変換素子毎の出力にはらつきが生じ、装置の性能(例えば、S/N比)が低下したり、光電変換素子を多数個配列しているため消費電力が大きくなってしまうという問題点を解消することが可能になる。なお、本発明の構成は、容量結合による制御手段を用いて、行の選択、非選択動作を可能とするものである。

【0059】請求項19記載の発明は、請求項15記載の光電変換装置に、垂直走査回路と、パルス駆動源と、電源とをさらに備え、全ての光電変換素子における増幅 50

部の制御領域を容置結合によって制御するための制御手段とリセット用制御手段とが、それぞれ水平読出し方向に共通接続されてパルス駆動のための上記垂直走査回路に接続され、全ての光電変換素子における転送部の転送用制御手段とリセット用電荷排出手段とがそれぞれ共通

接続されて、上記転送用制御手段が上記バルス駆動源 に、上記リセット用電荷排出手段が上記電源に接続され ていることを特徴とする。

【0060】つまり、バルス駆動源から送出される駆動 バルスが上記転送部の転送用制御手段に印加されると、 光電変換部において生成・蓄積された電荷(信号電荷)が増幅部の制御領域へ全画素同時に転送される。そして、垂直走査回路から送出される駆動バルスが上記増幅 部の制御領域を容量結合によって制御するための制御手段に印加されると、上記増幅部は増幅動作を行い、該増幅部から増幅された信号出力を生じる。

【0061】また、リセット用制御手段は、垂直走査回路から送出される駆動パルスに応じて動作(オン、オフ)し、との動作に応じてリセット用電荷排出手段に接続された電源からの電圧が上記増幅部の制御領域へ供給され、リセット用電荷排出手段の電位と同電位にされて、増幅部の制御領域が初期化される。

【0062】従って、増幅部が動作(オン)することなく、増幅部の制御領域をリセットすることが可能となり、装置の性能(例えば、S/N比)が低下したり、光電変換素子を多数個配列しているため消費電力が大きくなるということを抑制することが可能になる。なお、本発明の構成は、画面内同時性の成り立つ電子シャッター動作を可能とするものである。

【0063】請求項20記載の発明は、請求項15記載の光電変換装置に、各光電変換素子を水平読出し方向に共通駆動する垂直走査回路と、垂直走査に応じて上記増幅部の制御領域が初期化された直後の1水平ライン分の信号出力を記憶する第1の記憶手段と、垂直走査に応じて上記増幅部の制御領域へ上記電荷を転送した直後の1水平ライン分の信号出力を記憶する第2の記憶手段とをさらに備えたものである。

【0064】つまり、上記増幅部の制御領域が初期化された直後の信号出力には、ノイズ成分が混入しており、 又、上記光電変換部によって生成・蓄積された電荷(信

号電荷)を増幅部の制御領域へ転送した直後の信号出力には、電荷成分とノイズ成分とが混入している。従って、上記増幅部の制御領域が初期化された直後の信号出力と上記光電変換部によって生成・蓄積された電荷(信号電荷)を増幅部の制御領域へ転送した直後の信号出力とを分けて、それぞれの信号出力の差を取ることにより、電荷成分のみに応じた信号出力を得ることが可能になる。

[0065]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付

ことができる。

図面を参照して説明する。なお、各図中、同一符号は同 一又は相当部分を示し、重複する説明は省略する。

【0066】[実施形態1]図1は、本発明の実施形態 1による光電変換素子を示す概略構成図であり、図1

(a) は光電変換素子を示す概略構成平面図、図1

(b)は図1(a)のX1-X2線に沿った断面図、図 1 (c)は図1 (a)のY1-Y2線に沿った断面図で ある。なお、図1 (a) においては、アルミニウム膜2 0の図示を省略してあり、以下に示す図2(a)、図3 (a)、図7(a)、図10(a)、図13(a)及び 10 図14(a)においても同様にアルミニウム膜20の図 示を省略する。

【0067】これらの図において、実施形態1による光 電変換素子は、入射光に応じた電荷を生成して蓄積する フォトダイオード (光電変換部、PD) 1 と、制御領域 に受け取った電荷に応じた信号を出力する接合型電界効 果トランジスタ ((増幅部):以下、JFETとする) 2と、フォトダイオード1によって生成・蓄積された電 荷をJFET2の制御領域へ転送するための転送ゲート (転送制御部の転送用制御手段、TG) 3 と、JFET 2の制御領域へ転送された電荷を排出するためのリセッ トドレイン(リセット用電荷排出手段、RD)4と、リ セットドレイン4を制御するためのリセットゲート(リ セット用制御手段、RG)5とから主に構成されてい る。その他、転送ゲート配線3 a、リセットゲート配線 5 a 及びソース配線 1 6 a も、図に示すように形成され ている。

【0068】即ち、P型シリコン基板10上にチャネル 領域となるN型シリコン層11をエピタキシャル成長に よって形成し、このN型シリコン層11中に、例えばボ 30 ロン(B<sup>+</sup>)やリン(P<sup>+</sup>)をイオン注入あるいは熱拡散 法等によってP型フォトダイオード領域12やP型ゲー ト領域13及びリセットドレイン4等を形成する。さら に、絶縁層(図示せず)を介してリソグラフィー手法等 によって転送ゲート3やリセットゲート5を形成してフ ォトダイオード1やJFET2が形成される。なお、フ ォトダイオード1のNウェル領域14 (N-Well) は、PN接合で発生するキャリアのオーバーフローポテ ンシャルを所定の値にコントロールするために形成した ものである。

【0069】転送ゲート3は、フォトダイオード1のP 型フォトダイオード領域12とJFET2のP型ゲート 領域13とともにPチャネルMOSトランジスタ (MO SFET;図1(a), (c)参照)を構成している。 また、リセットゲート5も、リセットドレイン4のP型 リセットドレイン領域15とJFET2のP型ゲート領 域13とともにPチャネルMOSFET(図1(a),

(b)参照)を構成している。

【0070】フォトダイオード1は、シリコン層表面か

イオード領域12、N型シリコン層11(Nウェル領域 14を含む)、P型シリコン基板10を含み、いわゆる PNP型の縦型オーバーフロー構造を形成している。従 って、発生するキャリア(この実施形態1では正孔)に よるブルーミングやスミア等のにじみの現象を抑制する

【0071】JFET2は、N<sup>\*</sup>型ソース領域16、N<sup>\*</sup> 型ドレイン領域17、P型ゲート領域13、及びN型チ ャネル領域18 (Nチャネル) より構成されている。と れらは、シリコン層表面からP型シリコン基板10に向 かって順に、P型ゲート領域13、N型チャネル領域1 8、P型シリコン基板10のPNP型構造となるように 構成されている。この結果、本来バックゲートの機能を 有するN型チャネル領域18下部のP領域(この実施形 態1ではP型シリコン基板10)は、一定の電源に接続 されることになる。なお、シリコン層表面からP型シリ コン基板10の表面までの厚さ(高さ)は、約6μmで ある。

【0072】リセットゲート5とリセットドレイン4 は、リセットゲート5にパルス電圧を加えることによっ て、JFET2の制御領域(この実施形態1ではP型ゲ ート領域13)をリセットドレイン4の電位に初期化す る。従って、従来の光電変換素子のように、初期化動作 時にJFET2が動作(オン)することがなくなるた め、これらの素子を多数個配列して、例えば光電変換装 置を構成した場合でも、大電流が流れてトランジスタの バイアス点(動作点)が大きく変動し、JFET2の増 幅率が異なることによって生じていた光電変換素子毎の 出力のばらつきが生じることがなくなる。また、消費電 力も低下する。

【0073】なお、図1(a)では図示していないが、 図1(b), (c)から判るように、リセットドレイン 4への配線(メタル配線、この実施形態1ではアルミニ ウム(A1)膜20)は、フォトダイオード1以外の部 分を遮光するための遮光膜も兼用する。このアルミニウ ム膜20は、他の金属の膜でも良く、金属膜をスパッタ リング法によりデポジットさせることにより作製するこ とができる。

【0074】従って、遮光専用の膜をさらに上部に設け た素子に比べ、素子全体の厚み(高さ)を抑制すること ができ、集積度やフォトダイオード1に対する開口率を 向上させることができるとともに、フォトダイオード1 近傍にこの金属配線(アルミニウム膜20)を配設する 構造となるため、斜め入射光によるブルーミングやスミ ア等のにじみの現象を抑制することができる。

【0075】[実施形態2]図2は、本発明の実施形態 2による光電変換素子を示す概略構成図であり、図2

(a) は光電変換素子を示す概略構成平面図、図2

(b)は図2(a)のX1-X2線に沿った断面図、図 らP型シリコン基板10に向かって順に、P型フォトダ 50 2 (c)は図2 (a)のY1-Y2線に沿った断面図で ある。この実施形態2と実施形態1との相違は、光電変 換素子のフォトダイオードとJFET2の構造が異なっ ている点である。

【0076】即ち、実施形態2における光電変換素子の フォトダイオード1は、第1に、シリコン層表面からP 型シリコン基板10に向かって、NPNP型の縦型オー バーフロー構造の埋め込みフォトダイオード(NPNに よって埋め込みフォトダイオードが構成され、PNPに よってオーバーフロー構造が構成される)を形成してい る点が、実施形態1における光電変換素子のフォトダイ 10 オード1と異なっている。

【0077】従って、溢れ出るキャリアを吸収するオー バーフロー構造によって、ブルーミング、スミア等のに じみの現象を抑制することができるとともに、埋め込み フォトダイオードによってPN接合部に生じる空乏層が 表面に達しないため、暗電流が抑制される。また、電荷 が転送された後にフォトダイオードに電荷が残らない (完全空乏化になる) ため、残像、リセットノイズを抑 えた理想的な特性を得ることができる。

【0078】さらに、実施形態1においてフォトダイオ 20 ード1の周囲のみに形成されていたNウェル(N-We 11)領域14を、P型シリコン基板10上の全面に渡 って形成している点も異なっている。一般的に、縦型オ ーバーフロー構造のフォトダイオードは、内部量子効率 を高く保つため、PN接合をシリコン層表面からP型シ リコン基板 10側に向かってできるだけ深く形成するこ とが望ましい。

【0079】従って、Nウェル領域14はP型シリコン 基板10側に向かってさらに深く形成することになる が、この時、Nウェル領域14は横方向(P型シリコン 30 基板10に向かう方向と直交する方向)にも拡散(サイ ド拡散) するため、このサイド拡散を考慮した設計が必 要となる。この実施形態2では、P型シリコン基板10 上の全面に渡ってNウェル領域14を形成し、このNウ ェル領域14中にJFET2を形成する構造としたこと により、Nウェル領域14のサイド拡散の影響を防止 し、集積度や開口率を向上することができる。

【0080】この実施形態2における光電変換素子のJ FET2は、先ず第1に、全体的(特にチャネル部分) にシャロー化(浅接合化)した点が実施形態1における JFET2の構成と異なっている。増幅動作のみを行う JFET2をシャロー化することは、シャロー化した分 だけJFET2全体の大きさ (サイズ) が小さくなり、 光電変換素子全体の集積度やフォトダイオード1の開口 率を向上することができる。

【0081】加えて、増幅部としての特性、つまり相互 コンダクタンス (gm) の向上や、飽和特性の改善(飽 和領域のドレイン電圧依存性の低減)を図ることもでき る。相互コンダクタンス(gm)の向上は、例えばJF ET2を電流増幅に使用する場合に重要であることは勿 50 い。従って、横方向(基板に向かう方向と直交する方

論、ソースフォロワ動作させた場合(つまり、容量負荷 で電荷増幅させた場合)でも時定数の低減(スピードア ップ) あるいは感度の向上を図ることができる。

【0082】実施形態2による光電変換素子のJFET 2は、第2に、チャネル (Nチャネル) の上下にP型ゲ ート領域13 (図2 (b)参照、浅い第1導電型ゲート 領域13a及び第1導電型ゲート領域13b)を形成 し、チャネルの形成されていない部分でこれらの浅い第 1導電型ゲート領域13a及び第1導電型ゲート領域1 3 b を電気的に導通させている。さらに、このP型ゲー ト領域13とP型シリコン基板10をNウェル領域14 によって電気的に分離した点が実施形態1によるJFE T2と異なっている。この結果、光電変換素子自身の特 性に与える基板電圧の影響(基板バイアス効果)を大幅 に低減することができる。

【0083】さらに、先に述べたドレイン電圧依存性の 低減と基板バイアス効果の低減は、例えば光電変換装置 を構成して、JFET2をソースフォロワ動作させた場 合、光電変換装置に配設された各画素の感度の向上及び 感度のばらつき(例えば、固定パターンノイズ)を抑制 することに大きな効果を奏する。このように、実施形態 2による光電変換素子のJFET2は、実施形態1によ る光電変換素子に比べて集積度や開口率が向上するとと もに、感度が高く、感度のばらつきを抑制することがで

【0084】 [実施形態3]図3は、本発明の実施形態 3による光電変換素子を示す概略構成図であり、図3 (a) は光電変換素子を示す概略構成平面図、図3

(b)は図3(a)のX1-X2線に沿った断面図、図 3 (c) は図3 (a) のY1-Y2線に沿った断面図で ある。この実施形態3による光電変換素子は、フォトダ イオード1、JFET2、リセットドレイン4の各周囲 領域(転送ゲート3、リセットゲート5が形成される領 域を含む) に、予め定められた導電型(この実施形態3 ではN型)の素子分離領域21を形成した点が上記両実 施形態と異なっている。

【0085】通常、フォトダイオード1、JFET2、 リセットドレイン4の各P型領域は、それぞれNウェル 領域14中に形成されているため、このNウェル領域1 4によってそれぞれ電気的に分離されている。一般的 に、Nウェル領域14による分離は、集積度や開口率の 向上の観点から分離幅をできるだけ小さくすることが望

【0086】ところが、フォトダイオード1、JFET 2、リセットドレイン4の各P型領域は、光電変換素子 の性能上あまり浅く(シリコン表面から基板側に向かっ て浅く) 形成することができない。特に、フォトダイオ ード1については、量子効率の観点から、逆にシリコン 表面から基板側に向かって深く形成することが望まし

向)への広がり(サイド拡散)も大きくなり、分離幅の 縮小が行いにくいのが実情である。

【0087】そこで、この実施形態3においては、N型 の素子分離領域21を形成することによって、上記各P 型領域のサイド拡散を抑え、分離幅の縮小化を図り、光 電変換素子全体の集積度やフォトダイオード1の開口率 を向上させるとともに、転送ゲート3及びリセットゲー ト5のしきい値電圧制御を容易にすることができる。

【0088】[実施形態4]図4は、本発明の実施形態 4による光電変換素子を示す要部概略断面図である。図 10 4は、図2(c)又は図3(c)の一部分を示している ものであり、従って実施形態4は実施形態2又は3の図 でも説明可能である。この実施形態におけるフォトダイ オードは、図4に示すように、縦型オーバーフロー構造 の埋め込みフォトダイオード(BPD)1である。従っ て、ここで用いられるP型拡散層12は、次の条件を満 たす必要がある。なお、シリコン層表面には、SiO。 膜11aが形成されている。

- (1)過剰な光生成電荷が基板にオーバーフローすると
- (2) 信号読み出し時に光生成電荷がJFET2に完全 転送され、BPD1のP型拡散が完全空乏化すること。 【0089】一方、JFET2に用いられているP型拡 散は、次の条件を満たす必要がある。
- (1) BPD1から転送されてきた電荷が基板にオーバ ーフローしないこと。

(2) JFET2のソースN<sup>+</sup>拡散とNウェル領域14 がパンチスルーしないこと。(3)JFET2として動 作させるバイアス条件で空乏化しないこと。これらの条 件を同時に満たすためには、BPD1とJFET2とに 30 おけるP型拡散領域の濃度を別々に異なる値となるよう に設定した方が最適化し易い。

【0090】従って、本実施形態における光電変換素子 では、BPD1のP型拡散領域である電荷蓄積部12の 不純物濃度を5×10<sup>1</sup>°cm<sup>-3</sup>~3×10<sup>1</sup>°cm<sup>-3</sup>の範 囲とし、かつ、JFET2のP型拡散領域である第1導 電型ゲート領域13bの不純物濃度を6×101cm-3 ~3×10<sup>16</sup> c m<sup>-3</sup>の範囲とするとともに、これらの不 純物濃度を異なる値に設定する。ととで、とれらの不純 物濃度は、ボロンやリン等のイオン注入における注入条 40 件例えば注入量や拡散時間を変更することにより調整す ることができる。

【0091】[実施形態5]図5は、上記各実施形態1 ~4 (図1~図4)において示した光電変換素子を二次 元マトリクス状に配置した実施形態5による光電変換装 置の概略構成を示す模式回路図である。また、図6は、 図5 に示す模式回路図の動作を説明するためのパルスタ イミングチャートである。なお、以下に示す光電変換装 置では、図1において示した光電変換素子を用いた場合 変換素子を用いても同様である。

【0092】図5に示すように、各画素31は、入射光 に応じて電荷を生成して蓄積するフォトダイオード1、 制御領域で受け取った電荷に応じた信号出力を生じるJ FET2、及びフォトダイオード1で生成・蓄積された 電荷をJFET2の制御領域へ転送するための転送ゲー ト3を備えた転送制御素子(Pチャネル型MOSFE T) 31aと、JFET2の制御領域へ転送された電荷 を排出するためのリセット用電荷排出手段であるリセッ トドレイン4、及びこのリセットドレイン4を制御する ためのリセット用制御手段であるリセットゲート5を備 えたリセット素子(Pチャネル型MOSFET)31b とから構成されている。

【0093】各JFET2のソースは、マトリクス配置 の各列毎に垂直ソースライン32a, 32b, 32cに 共通に接続されている。また、各JFET2のドレイン 及びフォトダイオード1のカソード側には、図示しない 配線又は拡散層によって全画素共通にドレイン電源31 cが接続されている。さらに、各フォトダイオード1の アノード側及びJFET2の制御領域は、それぞれ転送 制御素子31aのソース又はドレインに接続されてい る。

【0094】転送制御素子31aの転送ゲート(転送ゲ ート電極) 3は、マトリクス配置の各行毎に垂直走査回 路34によって走査されるクロックライン33a,33 b, 33cに共通接続されている。垂直走査回路34か ら送出される駆動パルスφτει~φτειが印加されると、 転送制御素子31 a が各行毎に順次動作するようになっ ている。

【0095】リセット素子31bは、各画素31毎に設 けられており、リセットドレイン4は各行毎に互いに並 列に配設され、マトリクス配置の各行毎に垂直走査回路 34によって走査されるクロックライン50a,50 b, 50cに共通接続されている。また、リセットゲー ト(リセットゲート電極)5は、行ライン37aを介し て駆動パルス発生回路37に全画素共通接続されてい る。また、リセット素子31bのソースは、転送制御素 子31aのドレインと共有になっている。そして、リセ ットゲート(リセットゲート電極)5に駆動パルス発生 回路37から送出される駆動パルス φ ೄ が印加される と、このリセット素子31bが動作するようになってい る。

【0096】垂直ソースライン32a, 32b, 32c は、一方において、各列毎に光信号出力転送用MOSト ランジスタTs1、Ts2、Ts1及び暗出力転送用MOSト ランジスタTo1, To2, To3を介して光信号出力蓄積用 コンデンサ (第2の記憶素子) Cs1, Cs2, Cs3及び暗 出力蓄積用コンデンサ(第1の記憶素子) C 。, , C 。, , C。,の一方の電極に接続されるとともに、水平読出し選 を例にして説明するが、図2~図4において示した光電 50 択用MOSトランジスタT#si, T#sz, T#si, T#bi,

(V<sub>RV</sub>=GNDの時) にすることができるようになって

Tnoz, Tnogを各々経て信号出力線38及び暗出力線3 9に接続されている。なお、一般的に、これら信号出力 線38及び暗出力線39には、寄生容量C,,, C,,が存 在する。また、これら信号出力線38及び暗出力線39 の一方にはバッファアンプ38a,39aが接続されて いる。

【0097】また、信号出力線38及び暗出力線39 は、他方において、送出される映像信号をリセットする ための水平読出しリセット用MOSトランジスタ TRHS, TRHOのドレインが接続されており、またこの水 10 平読出しリセット用MOSトランジスタTRHS, TRHOの ソースは、上記光信号出力蓄積用コンデンサCsi,

 $C_{52}$ ,  $C_{53}$ 及び暗出力蓄積用コンデンサ $C_{53}$ ,  $C_{62}$ , C。。の他方の電極と接続しつつ、接地(GND)されてい る。そして、この水平読出しリセット用MOSトランジ スタTaus, Tauoのゲート電極に、駆動パルス発生回路 43から送出される駆動パルス Φ μμが印加されると、水 平読出しリセット用MOSトランジスタTRHS, TRHDが 動作するようになっている。

【0098】上記水平読出し選択用MOSトランジスタ  $T_{H51}$ ,  $T_{H52}$ ,  $T_{H53}$ ,  $T_{H01}$ ,  $T_{H02}$ ,  $T_{H03}$ の各々のゲ ート電極には、水平走査回路40に接続された水平選択 信号ライン40a, 40b, 40cが各列毎に共通接続 され、水平走査回路40から送出される駆動パルスゆれ ~ φ ", によって水平読出しが制御されるようになってい

【0099】上記光信号出力転送用MOSトランジスタ Ts1, Ts2, Ts3の各ゲート電極は光信号用クロックラ イン41aを介して、また上記暗出力転送用MOSトラ ンジスタ To1, To2, To3の各ゲート電極は暗出力用ク ロックライン42aを介して、それぞれ駆動バルス発生 回路41及び42に接続され、駆動パルス発生回路41 及び42から送出されるそれぞれの駆動パルスφτ ある いはφτgが印加されると、これら光信号出力転送用MO SトランジスタTs1、Ts2、Ts3及び暗出力転送用MO SトランジスタT $_{01}$ , T $_{02}$ , T $_{03}$ が各々予め定められた 順序で交互に動作するようになっている。

【0100】上記垂直ソースライン32a, 32b, 3 2 c は、他方において、各列毎にリセット用トランジス 読み出し用定電流源44a、44b、44cに接続され ている。また、各リセット用トランジスタT<sub>RV1</sub>,

 $T_{RV2}$ ,  $T_{RV3}$ のソースには電源電圧 $V_{RV}$ が供給され、ソ ースフォロワ読み出し用定電流源44a, 44b, 44 cには電源電圧Vcsが供給されている。

【0101】なお、リセット用トランジスタTgv1, T Rvz, TRv3のゲート電極にはリセットパルス ØRvが供給 され、このリセットパルスøgyがハイレベルになると、 リセット用トランジスタTRv1, TRv2, TRv3が導通し て垂直ソースライン32a,32b,32cを接地状態 50 作を行う。なお、この期間t $_{12}$ 中において、駆動パルス

いる。 【0102】また、ソースフォロワ読み出し用定電流源 44a, 44b, 44cは、ソースフォロワ動作の時定

数を制御すると同時に、各画素31ごとのバイアス点の 変動等による時定数ばらつきを抑えて、ゲインを揃え、 固定パターンノイズ(以下、FPNとする)を抑えるよ うになっている。

【0103】次に、図6に示すパルスタイミングチャー トを参照しながら、本発明の実施形態5による光電変換 装置の動作について説明する。なお、図6において、t 11~ t 11までの期間は、第1行目の画素31の読み出し 動作を示しており、以下 t \*\*, なよび t \*\*, ~ t \*\*, が 期間は、それぞれ第2行目、第3行目に対応している。 また、t11~t14のそれぞれは、t11がJFET2の初 期化動作、 t12が初期化後の第1行目のJFET2のソ ースフォロワ動作、 t 🕠 が第 1 行目のフォトダイオード 1からJFET2への信号電荷の転送動作、 t 14 が転送 後のJFET2のソースフォロワ動作に対応した期間 で、この4つの動作は水平ブランキング期間内に行われ る。また、 t15は映像信号出力期間である。

【0104】先ず、図6に示すように、期間 t11の最初 で、駆動パルス Φ κ ο 1 をハイレベル (駆動パルス Φ κ ο 2 とゆ。13 はローレベルのまま)にして、第1行目の画素 31のリセットドレイン4に電圧駆動パルスを印加す る。そして、既にローレベルで導通状態(オン)とされ ている全ての画素31のリセットゲート5を経由して、 ハイレベルの電圧が第1行目の画素31のJFET2の 制御領域に、ローレベルの電圧が第2行目以後の画素3 1のJFET2の制御領域に伝わり、これらのJFET 2の制御領域が初期化(電荷が排出)されるとともに、 第1行目の各JFET2は選択(オン)され、第2行目 以後の各JFET2は非選択(オフ)とされる。

【0105】即ち、リセットドレイン4に電圧駆動パル ス  $(\phi_{R01}, \phi_{R02}, \phi_{R03})$  が送出された行によって、 JFET2の選択(オン)・非選択(オフ)がなされる とともに、選択された行のJFET2の制御領域がハイ レベルの電位に、非選択行のJFET2の制御領域がロ ーレベルの電位に初期化される。

【0106】そして、期間 t,,の終わり (期間 t,,の最 初)において、駆動パルスφεをハイレベルにして、リ セットゲート5を非導通状態(オフ)にすることによっ て、各JFET2の制御領域は、選択(オン)、非選択 (オフ) 状態を保持したまま、フローティング状態とさ

【0107】同時に(期間 t12の最初で)、駆動パルス φ<sub>R</sub>νをローレベルにして、リセット用トランジスタT ĸvı~Tĸv」を遮断状態(オフ)にして、この期間 t , 2中 において、第1行目の各JFET2がソースフォロワ動 φτωはハイレベルで暗出力転送用MOSトランジスタT p, To, To, は導通状態(オン)となっており、各J FET2の制御領域の初期化直後の電位に対応した出力 (暗時出力)電圧が暗出力蓄積用コンデンサC。1, Coz, Cojに蓄積される。

【0108】期間 t,,においては、駆動パルスφτε、を ローレベルにして転送ゲート3を非導通状態(オフ)か ら導通状態(オン)にするとともに、駆動パルス φτ s を ハイレベルに、駆動パルスφτοをローレベルにして、光 信号出力転送用MOSトランジスタTs1, Ts2, Ts3を 10 導通状態(オン)に、暗出力転送用MOSトランジスタ To1, To2, To3を非導通状態(オフ)にする。

【0109】この結果、第1行目のフォトダイオード1 で生成・蓄積された電荷がJFET2の制御領域へ転送 される。なお、電荷を転送した後のJFET2の制御領 域の電位は、電荷量/ゲート容量の分だけ変化(この場 合は上昇) する。また、図6において、駆動パルスゆ тыがローレベルのときに転送ゲート3が導通状態(オ ン) になるのは、転送制御素子31aがPチャネル型で あるため、他の駆動パルスと極性が反対になるためので

【0110】期間 t14においては、期間 t12と同様に、 駆動パルスφτατをハイレベルして第1行目の転送ゲー ト3を非導通状態(オフ)にして、フォトダイオード1 において光電変換された電荷が蓄積される状態にすると ともに、駆動パルスφ<sub>RV</sub>をローレベルにしてリセット用 トランジスタT<sub>RV1</sub>~T<sub>RV3</sub>を遮断状態(オフ)にして、 第1行目の各JFET2がソースフォロワ動作をする。 【0111】なお、この期間tュ。中において、駆動パル スφτsはハイレベルであるため、光信号出力転送用MO SトランジスタT51, T52, T53が導通状態(オン)と なっており、各JFET2の制御領域へ電荷を転送した 後の電位に対応した出力(信号出力)電圧が、光信号出 力蓄積用コンデンサC51、C52、C53に蓄積される。

【0112】期間 t1,においては、駆動パルスのRD1,  $\phi_{RG}$ ,  $\phi_{TS}$ のそれぞれをローレベルに、駆動パルス $\phi_{RV}$ をハイレベルにして、光信号出力蓄積用コンデンサCs1 ~Cs,及び暗出力蓄積用コンデンサCo,~Co,に蓄積さ れた出力電圧(映像信号)を出力端子Vos, Vooに出力 する状態にする。

【0113】そして、水平走査回路40から駆動パルス  $\phi_{"1} \sim \phi_{"3}$ 及び駆動パルス発生回路43から駆動パルス φ<sub>κμ</sub>を順次出力して、光信号出力蓄積用コンデンサC<sub>51</sub> ~C,,及び暗出力蓄積用コンデンサC,,~C,,に蓄積さ れた映像信号をそれぞれ信号出力線38及び暗出力線3 9の水平読み出しラインに読み出し、出力端子Vos, V 。。から映像信号を出力しつつ、信号出力線38及び暗出 力線39の水平読み出しラインのリセットを行う。

【0114】なお、出力端子V。s, V。。から得られた映 像信号は、図示しない外部演算回路によって演算処理さ 50 【0119】 [実施形態7]図8は、図7において示し

れる。これは、出力端子V。こから得られる映像信号には 電荷成分(S)と暗成分(D)が含まれており、出力端 子V。。から得られる映像信号には暗成分(D)のみが含 まれているため、出力端子Vos, Vooから得られた映像 信号を演算処理(減算処理(Vos-Voo))することに より、電荷成分(S)に応じた映像信号のみを抽出する ためである。

【0115】以上に示した期間t,,~t,,に対する第1 行目の読み出し動作は、期間 t ,1~ t ,5 および期間 t ,1 ~ t ,, において、それぞれ第2行目、第3行目に対して 繰り返して、同様に行われる。なお、この第1の実施形 態における光電変換装置では、リセット素子31bが、 各画素31毎に設けられ、リセットドレイン4が各行毎 に互いに並列に配設されているため、リセット動作が極 めて高速となり、期間 t,1~ t,5, t,1~ t,1,5 t,1~ tいの全体的な時間は、従来の光電変換装置に比べて短 くすることができる。

【0116】[実施形態6]図7は、本発明の実施形態 6による光電変換素子を示す概略構成図であり、図7 (a)は光電変換素子を示す概略構成平面図、図7

(b)は図7(a)のX1-X2線に沿った断面図、図 7 (c) は図7 (a) のY1-Y2線に沿った断面図で ある。図7に示す光電変換素子と図1~図4において示 した光電変換素子との最も異なる点は、JFET2(増 幅部) に容量結合によってJFET2の制御領域を制御 するためのゲート電極50が形成されている点であり、 他の構成については図1において示した光電変換素子と 同一である。なお、図7に示すように、ゲート配線51 が形成されている。

【0117】通常、JFET2には、制御領域を容量結 合によって制御するためのゲート電極50が形成されて いる。しかしながら、図1~図4において示した光電変 換素子では、ゲート電極50が形成されていない。この ことによる相違点は、以下に示すゲート電極50を形成 した場合の光電変換素子(図7)を二次元マトリクス状 に配列した光電変換装置の説明とともに説明する。

【0118】なお、図7に示す光電変換素子は、ゲート 電極50が形成されている点を除けば図1において示し た光電変換素子と同一である。従って、図7に示す光電 変換素子のフォトダイオード1やJFET2の構造を図 2において示した光電変換素子のフォトダイオード1や JFET2の構造と同一にすると、ゲート電極50が形 成されている点を除き、図2において示した光電変換素 子と同一になり、又図7に示す光電変換素子のフォトダ イオード1、JFET2、リセットドレイン4の各相互 領域間に、予め定められた導電型の素子分離領域21を 形成すると、ゲート電極50が形成されている点を除 き、図3において示した光電変換素子と同一になる。と のため、同一部分についての説明は省略する。

20

26

た光電変換素子を二次元マトリクス状に配置した本発明の実施形態7による光電変換装置の概略構成を示す模式回路図である。図5(実施形態5)と図8とを比較すると、図8に示す光電変換装置では、画素(光電変換素子)31を構成するJFET2のゲート電極50が、各行毎に共通に垂直走査回路34に接続されている。そして、このゲート電極50がパルス駆動される。

【0120】つまり、図5において説明した光電変換装置では、JFET2にゲート電極50が形成されていなかったため、リセットドレイン4が上記ゲート電極50の代わりにバルス駆動されていた。しかし、図5において説明した光電変換装置では、JFET2にゲート電極50が形成されていないため、ゲート電極50への配線が不要となる。従って、ゲート電極50を形成しない分だけ、JFET2の制御領域の容量を小さくすることができ、感度を高くすることができるという利点を有している。一方、図8に示す光電変換装置では、JFET2にゲート電極50が形成されているため、リセットドレイン4をパルス駆動する必要がないという利点を有している。

【0121】図8に示す光電変換装置において、各画素31は、入射光に応じた電荷を生成して蓄積するフォトダイオード1、制御領域を容量結合によって制御するためのゲート電極50、制御領域に受け取った電荷に応じた信号出力を生じるJFET2、及びフォトダイオード1で生成・蓄積された電荷をJFET2の制御領域へ転送するための転送ゲート3を備えた転送制御素子(Pチャネル型MOSFET)31aと、JFET2の制御領域へ転送された電荷を排出するためのリセットドレイン4、及びこのリセットドレイン4を制御するためのリセットドレイン5を備えたリセット素子(Pチャネル型MOSFET)31bとから構成されている。

【0122】各JFET2のソースは、マトリクス配置の各列毎に垂直ソースライン32a,32b,32cに共通に接続されている。また、各JFET2のドレイン及びフォトダイオード1のカソード側には、図示しない配線又は拡散層によって全画素共通にドレイン電源31cが接続されている。さらに、各フォトダイオード1のアノード側及びJFET2の制御領域は、それぞれ転送制御素子31aのソース又はドレインに接続されている。

【0123】転送制御素子31aの転送ゲート(転送ゲート電極)3は、マトリクス配置の各行毎に垂直走査回路34によって走査されるクロックライン33a、33b、33cに共通接続され、上記垂直走査回路34から送出される駆動パルス $\phi$ T<sub>c1</sub> $\sim$  $\phi$ T<sub>c2</sub>が印加されると、転送制御素子31aが各行毎に順次動作するようになっている

【0124】JFET2に備えられたゲート電極50  $\phi_{*1}\sim \phi$ は、マトリクス配置の各行毎に垂直走査回路34によっ 50 ている。

て走査されるクロックライン35a, 35b, 35c 共通接続され、上記垂直走査回路34から送出される駆動パルス $\phi_{c1}$ ,  $\phi_{c3}$ が印加されると、JFET2が各行毎に順次動作するようになっている。

【0125】リセット素子31bは、各画素31毎に設けられており、リセットドレイン4は各行毎に互いに並列に配設され、行ライン36を介して電源電圧 $V_{\rm RD}$ に全画素共通接続されており、また、リセットゲート(リセットゲート電極)5も行ライン37aを介して駆動パルス発生回路37に全画素共通接続されている。また、リセット素子31bのソースは、転送制御素子31aのドレインと共有になっている。そして、リセットゲート5に上記駆動パルス発生回路37から送出される駆動パルス $\phi_{\rm RD}$ が印加されると、このリセット素子31bが動作して、JFET2の制御領域が初期化されるようになっている。

【0127】また、上記信号出力線38及び暗出力線39は、送出される映像信号をリセットするための水平読出しリセット用MOSトランジスタ $T_{RHS}$ ,  $T_{RHD}$ のドレインが接続されており、またこの水平読出しリセット用MOSトランジスタ $T_{RHS}$ ,  $T_{RHD}$ のソースは、上記光信号出力蓄積用コンデンサ $C_{S1}$ ,  $C_{S2}$ ,  $C_{S3}$ 及び暗出力蓄積用コンデンサ $C_{01}$ ,  $C_{02}$ ,  $C_{03}$ の他方の電極と接続しつつ、接地(GND)されている。そして、この水平読出しリセット用MOSトランジスタ $T_{RHS}$ ,  $T_{RHD}$ のゲート電極に、駆動パルス発生回路43から送出される駆動パルス $\sigma_{RH}$ が印加されると、水平読出しリセット用MOSトランジスタ $T_{RHS}$ ,  $T_{RHD}$ が動作するようになっている。

【0129】上記光信号出力転送用MOSトランジスタ Ts1, Ts2, Ts3の各ゲート電極は、光信号用クロック ライン41aを介して、また上記暗出力転送用MOSト ランジスタT<sub>01</sub>, T<sub>02</sub>, T<sub>03</sub>の各ゲート電極は暗出力用 クロックライン42aを介して、それぞれ駆動パルス発 生回路41及び42に接続され、駆動バルス発生回路4 11及び42から送出されるそれぞれの駆動パルスφ<sub>τ</sub>。 あるいはゆいが印加されると、これら光信号出力転送用 MOSトランジスタTs1, Ts2, Ts3及び暗出力転送用 MOSトランジスタTon, Ton, Tonが各々予め定めら れた順序で交互に動作するようになっている。

【0130】上記垂直ソースライン32a, 32b, 3 2 cは、他方において、各列毎にリセット用トランジス 読み出し用定電流源44a,44b,44cに接続され ており、各リセット用トランジスタTRv1, TRv2, T gv,のソースには電源電圧Vgvが供給され、ソースフォ ロワ読み出し用定電流源44a, 44b, 44cには電 源電圧Vcsが供給されている。

 $\{0131\}$ なお、リセット用トランジスタ $T_{RV1}$ , T gvz, Tgvgのゲート電極には、リセットパルスのgvが供 給され、このリセットパルス $\phi_{uv}$ がハイレベルになる と、リセット用トランジスタT<sub>RV1</sub>, T<sub>RV2</sub>, T<sub>RV3</sub>が導 通して垂直ソースライン32a,32b,32cを接地 状態(V<sub>RV</sub>=GNDの時)にすることができるようにな っている。また、ソースフォロワ読み出し用定電流源4 4a, 44b, 44cは、ソースフォロワ動作の時定数 を制御すると同時に、各画素31 ごとのバイアス点の変 動等による時定数ばらつきを抑えて、ゲインを揃え、F PNを抑えるようになっている。

【0132】次に、図9に示すパルスタイミングチャー トを参照しながら、図8に示した本発明の実施形態7に よる光電変換装置の動作について説明する。なお、図9 において、 t11~ t1,までの期間は、第1行目の画素3 1の読み出し動作を示しており、以下 t 21~ t 25および t,1~t,1の期間は、それぞれ第2行目、第3行目に対 応している。また t , 1 ~ t , 4 はそれぞれ、 t , 1 が J F E T2の初期化動作、t12は初期化後の第1行目のJFE T2のソースフォロワ動作、t13は第1行目のフォトダ イオード1からJFET2への信号電荷の転送動作、t 1.は転送後のJFET2のソースフォロワ動作に対応し た期間で、この4つの動作は水平ブランキング期間内に 行われる。 t15は映像信号出力期間である。

【0133】先ず、図9に示すように、期間 t , , におい て、駆動パルスゆい及びゆいをハイレベルにして、各画 素31のリセットゲート5を導通状態(オン)から非導 通状態(オフ)にするとともに、暗出力転送用MOSト ランジスタTo1, To2, To3を導通状態(オン)にす

【0134】との結果、全てのJFET2の制御領域

は、リセットドレイン4と行ライン36を介して接続さ れた電源電圧V<sub>Ro</sub>の電位にされ、初期化(電荷が排出) されて、フローティング状態になる。なお、図9におい て、リセットゲート5への駆動パルスφεςがハイレベル で非導通状態(オフ)となっているのは、リセット素子 31bがPチャネル型であるため、他の駆動パルスと極

性が反対になるためのである。

【0135】次いで、期間 t 12の最初で、駆動バルスΦ c1をハイレベルにして、第1行目のJFET2のゲート 電極の電位を上昇させ、第1行目のJFET2が選択 (オン)され、第2行目以後のJFET2は非選択(オ フ)とされる。即ち、リセットゲート5が非導通状態 (オフ)となっているときに、JFET2のゲート電極 へ駆動パルス ( $\phi_{c1}$ ,  $\phi_{c2}$ ,  $\phi_{c3}$ ) が送出された行によ って、JFET2の選択(オン)・非選択(オフ)がな される。

【0136】同時に(期間 t12の最初)、駆動パルス φ RVをローレベルにして、リセット用トランジスタTRV1 ~Tgv₃を遮断状態(オフ)にして、この期間tュュ中に 20 おいて、第1行目の各JFET2がソースフォロワ動作 を行う。なお、この t 12 の期間中において、駆動バルス φτοはハイレベルで暗出力転送用MOSトランジスタT p1, To2, To3が導通状態(オン)となっており、JF ET2の制御領域の初期化直後の電位に対応した出力 (暗時出力)電圧が暗出力蓄積用コンデンサC。1, Co.z, Co.jに蓄積される。

【0137】期間 t,,においては、駆動パルスφ,,を ローレベルにして転送ゲート3を非導通状態(オフ)か ら導通状態(オン)にするとともに、駆動パルス Φτ 5 を ハイレベルに、駆動パルスφτοをローレベルにして、光 信号出力転送用MOSトランジスタTs1, Ts2, Ts3を 導通状態(オン)とし、暗出力転送用MOSトランジス タT。1, T。2, T。3を非導通状態(オフ)にする。

【0138】との結果、第1行目のフォトダイオード1 で生成・蓄積された電荷がJFET2の制御領域へ転送 される。なお、電荷を転送した後のJFET2の制御領 域の電位は、電荷量/ゲート容量の分だけ変化(この場 合は上昇)する。また、図9において、転送ゲート3へ の駆動パルスφτ ε1がローレベルで導通状態(オン)と なっているのは、転送制御素子31aがPチャネル型で あるため、他の駆動パルスと極性が反対になるためので ある。

【0139】期間t、においては、期間t、と同様に、 駆動パルス Φτ 61 をハイレベルにして第1行目の転送ゲ ート3を非導通状態(オフ)にしてフォトダイオード1 において光電変換された電荷を蓄積する状態にするとと もに、駆動パルスøgvをローレベルにしてリセット用ト ランジスタTgv1~Tgv3を遮断状態(オフ)にして、第 1行目のJFET2がソースフォロワ動作をする。

50 【0140】なお、この t14の期間中において、駆動パ

ルス $\phi_{\tau_s}$ はハイレベルで光信号出力転送用MOSトランジスタ $T_{s_1}$ ,  $T_{s_2}$ ,  $T_{s_3}$ をが導通状態(オン)となっており、JFET2の制御領域へ電荷を転送した後の電位に対応した出力(信号出力)電圧が、光信号出力蓄積用コンデンサ $C_{s_1}$ ,  $C_{s_2}$ ,  $C_{s_3}$ に蓄積される。

【0141】期間 $t_1$ 、においては、駆動バルス $\phi_{c1}$ 、 $\phi_{RG}$ 、 $\phi_{\tau s}$ のそれぞれをローレベルに、駆動バルス $\phi_{RV}$ を ハイレベルにして、光信号出力蓄積用コンデンサ $C_{s1}$ ~  $C_{s3}$ 及び暗出力蓄積用コンデンサ $C_{o1}$ ~ $C_{o3}$ 、に蓄積され た出力電圧(映像信号)を出力端子 $V_{os}$ 、 $V_{oo}$ に出力す 10 る状態にする。

【0142】そして、水平走査回路40から駆動バルス  $\phi_{H1}\sim\phi_{H3}$ 及び駆動バルス発生回路43から駆動バルス  $\phi_{RH}$ を順次出力して、光信号出力蓄積用コンデンサ $C_{51}\sim C_{53}$ 及び暗出力蓄積用コンデンサ $C_{51}\sim C_{53}$ 及び暗出力蓄積用コンデンサ $C_{51}\sim C_{53}$ 及び暗出力蓄積用コンデンサ $C_{53}\sim C_{53}$ 及び暗出力蓄積用コンデンサ $C_{53}\sim C_{53}$ 及び暗出力線9の水平読み出しラインに転送し、出力端子90水平読み出しラインのリセットを行う。

【0143】なお、出力端子 $V_{os}$ , $V_{oo}$ から得られた映 20像信号は、図示しない外部演算回路によって演算処理される。これは、出力端子 $V_{os}$ から得られる映像信号には電荷成分(S)と暗成分(D)が含まれており、又出力端子 $V_{oo}$ から得られる映像信号には暗成分(D)のみが含まれているため、出力端子 $V_{os}$ , $V_{oo}$ から得られた映像信号を演算処理(減算処理( $V_{os}-V_{oo}$ ))することにより、電荷成分(S)に応じた映像信号のみを抽出するためである。

【0144】以上に示した期間 t<sub>11</sub>~t<sub>1</sub>、に対する第1行目の読み出し動作は、期間 t<sub>21</sub>~t<sub>2</sub>、および期間 t<sub>31</sub>~t<sub>3</sub>、において、それぞれ第2行目、第3行目に対して繰り返して同様に行われる。なお、図8に示す光電変換装置では、リセット素子31bが、各画素31毎に設けられ、リセットドレイン4が各行毎に互いに並列に配設されているため、リセット動作が極めて高速となり、期間 t<sub>11</sub>~t<sub>1</sub>、t<sub>21</sub>~t<sub>2</sub>、および t<sub>31</sub>~t<sub>3</sub>、の全体的な時間は、従来の光電変換装置に比べて短くすることができる

【0145】[実施形態8]図10は、本発明の実施形態8による光電変換素子を示す概略構成図であり、図10(a)は光電変換素子を示す概略構成平面図、図10(b)は図10(a)のX1-X2線に沿った断面図、図10(c)は図10(a)のY1-Y2線に沿った断面図である。この実施形態7による光電変換素子は、増幅部にデプレッション型のMOSトランジスタ52を用いている点が上記各実施形態と異なっている。

【0146】MOS型トランジスタは、JFET2と同様に、増幅動作時に電荷(信号電荷)を破壊しない、所謂非破壊増幅動作を行うため、FPNが発生しにくいという特性を有しており、さらに、信号電荷のリセット

時、制御領域(ゲート電極下のシリコン (N型シリコン層)表面) に電荷が残らないため、残像およびリセットノイズも発生しにくいという特性を有している。従って、例えば画面内で同時性の成り立つ電子シャッタ動作が可能な固体撮像素子を構成するには好適である。

【0147】 [実施形態9] 図11は、図10に示した 光電変換素子を二次元マトリクス状に配置した本発明の 実施形態9による光電変換装置の概略構成を示す模式回 路図である。また、図12は、図11に示す模式回路図 の動作を説明するためのバルスタイミングチャートであ ス

【0148】図11に示す光電変換装置と図5(実施形態5),図8(実施形態7)において説明した光電変換装置との相違点は、画素31の増幅部をMOSトランジスタ(MOS)とし、転送制御素子31aの転送ゲート3を行ライン51aを介して駆動バルス発生回路51によって全画素共通接続するとともに、リセット素子31bのリセットゲート5を各行毎にクロックライン52a,52b,52cを介して垂直走査回路34から送出される駆動パルス( $\phi_{RG1}\sim\phi_{RG3}$ )によって動作するようにした点である。なお、図11に示す光電変換装置にすることによって、一画面内で同時性のある電子シャッター動作を実現することができる光電変換装置とすることができる。

【0149】以下、図12に示すパルスタイミングチャートを参照しながら、図11に示した光電変換装置の動作について説明する。先ず、図12に示すように、期間  $t_{10}$ において、駆動パルス $\phi_{10}$ 及び $\phi_{RG1} \sim \phi_{RG3}$ をローレベルにして、各画素31の転送ゲート3及びリセット がト5を非導通状態(オフ)から導通状態(オン)にする。

【0150】この結果、全てのフォトダイオード1とリセットドレイン4、及び全てのMOSトランジスタ(MOS)の制御領域とリセットドレイン4が導通状態(オン)となり、フォトダイオード1は空乏化して初期化され、またMOSトランジスタ(MOS)の制御領域は、リセットドレイン4の電位に初期化される。

【0151】そして、期間  $t_{11}$ において、駆動パルス  $\phi_{16}$ 及び  $\phi_{861}$   $\sim \phi_{863}$  をハイレベルにして、各画素 310 転送 ゲート 3 及びリセット ゲート 5 を非導通状態(オフ)にし、フォトダイオード 1 を電荷蓄積状態にする。そして、期間  $t_{11}$  がシャッタータイムとなる。

る。なお、このMOSトランジスタ(MOS)の初期化 動作は、静止画モードの撮像において、フォトダイオー ド1を長時間蓄積する場合には必要な動作である。

【0153】期間 t 1, 1において、駆動パルスφτςをハイ レベルにして、光信号出力転送用MOSトランジスタT 51, T52, T53を導通状態(オン)にしておき、駆動パ ルス $\phi_{RG1} \sim \phi_{RG3}$ をハイレベルにして各画素31のリセ ットゲート5を非導通状態(オフ)にすると共に、駆動 パルスφ, をローレベルにして各画素31の転送ゲート 3を導通状態(オン)にする。この結果、期間 t<sub>11</sub>にお 10 いて生成・蓄積された電荷がフォトダイオード1からM OSトランジスタの制御領域へ転送される。

【0154】そして、期間tィ~tィィにおいては、図 5,図8において示した光電変換装置とほぼ同様に、第 1行目の画素31の読み出し動作を行う。即ち、図11 に示す光電変換装置の期間 t14~ t17までの動作は、図 5, 図8において示した光電変換装置の期間 t 1, ~ t 1, までの動作に相当する。

【0155】つまり、図10に示す光電変換装置の期間 t14において、駆動パルスφ61をハイレベルにして容量 結合によって動作するゲート電極の電位を上昇させると ともに、駆動パルスφ<sub>RV</sub>をローレベルにしてリセット用 トランジスタT<sub>RV1</sub>~T<sub>RV3</sub>を遮断状態(オフ)にし、第 1行目のMOSトランジスタ(MOS)がソースフォロ ワ動作(容量負荷による電荷増幅動作)を行う。なお、 各行単位のMOSトランジスタ(MOS)の選択(オ ン)・非選択(オフ)は、このゲート電極への駆動パル ス $(\phi_{c_1} \sim \phi_{c_1})$ によって決定される。

【0156】また、この期間 t14中において、駆動バル スφτςは既にハイレベルで光信号出力転送用MOSトラ ンジスタTs1, Ts2, Ts3が導通状態(オン)となって おり、MOSトランジスタの制御領域へ電荷を転送した 後の電位に対応した出力(信号出力)電圧が、光信号出 力蓄積用コンデンサCs1, Cs2, Cs3に蓄積される。

【0157】次いで、期間 t, なおいて、駆動パルスゆ τ<sub>0</sub>をハイレベルにして、暗出力転送用MOSトランジス タT。1, T。2, T。3を導通状態(オン)にしておき、駆 動パルスφκαをローレベルにして、第1行目のリセット ゲート5を導通状態(オン)にして、第1行目のMOS トランジスタ(MOS)の制御領域をリセット(電荷を 排出)する。さらに、期間 t, において、再度駆動バル スøgvをローレベルにしてリセット用トランジスタT RV1 ~ TRV 』を遮断状態(オフ)にし、第1行目のMO Sトランジスタ (MOS) がリセット後のソースフォロ ワ動作を行う。

【0158】なお、との期間 t16中において、駆動パル スφτοは既にハイレベルで暗出力転送用MOSトランジ スタT。」、 T。」、 T。」が導通状態 (オン) となってお り、MOSトランジスタ(MOS)の制御領域のリセッ

積用コンデンサCo1, Co2, Co3に蓄積される。

【0159】そして、期間 t1,において、駆動バルスφ  $\epsilon_1$ ,  $\phi_{\tau_0}$ のそれぞれをローレベルに、駆動パルス $\phi_{g_V}$ を ハイレベルにして、光信号出力蓄積用コンデンサCs1~ Cs,及び暗出力蓄積用コンデンサCo,~Co,に蓄積され た出力電圧(映像信号)を出力端子Vos, Vooに出力す る状態にして、水平走査回路40から駆動パルスφ11~ φη 及び駆動パルス発生回路43から駆動パルスφη を 順次出力して、光信号出力蓄積用コンデンサCs1~Cs3 及び暗出力蓄積用コンデンサC。、、、C。、に蓄積された映 像信号をそれぞれ信号出力線38及び暗出力線39の水 平読み出しラインに転送し、出力端子Vos, Vooから映 像信号を出力しつつ、信号出力線38及び暗出力線39 の水平読み出しラインのリセットを行う。これで第1行 目の読み出し動作が終了し、t,4~t,7およびt,4~t 37において、第2行目、第3行目の読み出し動作が行わ れる。

【0160】なお、図11に示した光電変換装置では、 主として静止画を撮像する場合ついて説明したが、動画 を撮像する場合についても適用することができる。即 ち、動画を撮像する場合でも電子シャッター動作を行う ことができる。但し、動画を撮像する場合は、図12に 示した期間 t10~ t13の動作(動画の場合期間 t12は不 要である。)は、垂直ブランキング期間内に行う必要が あるため、シャッタースピードの可変範囲には一定の制 限が生ずる。

【0161】また、図11に示した光電変換装置(画面 内で同時性のある電子シャッター動作)では、容量結合 で動作可能な構造であれば、MOS型に限らず、JFE T型、バイポーラ型光電変換素子でも適用することがで きる。但し、2回のソースフォロワ動作の間に、リセッ ト動作が入るため、リセットノイズを発生しないMOS 型が最も好ましい。

【0162】[実施形態10]図13は、本発明の実施 形態10による光電変換素子を示す概略構成図であり、 図13(a)は光電変換素子を示す概略構成平面図、図 13 (b) は図13 (a) のX1-X2線に沿った断面 図、図13(c)は図13(a)のY1-Y2線に沿っ た断面図である。図13に示す光電変換素子において は、増幅部にバイポーラトランジスタ53を用いている 点が上記各実施形態と異なっている。 なお、エミッタ5 4、コレクタ55及びベース56が図に示すように構成 されるとともに、エミッタ配線57が形成されている。 【0163】図13に示すバイポーラトランジスタ53 では、通常用いられるN<sup>+</sup>型埋め込みコレクタ、又は高 濃度N型基板を用いたコレクタを形成せずに、コレクタ 領域をシリコン(Nウェル領域14)表層部に設けてい る。従って、バイポーラトランジスタ53と縦型オーバ ーフロー構造のフォトダイオード1の組合せが可能とな ト後の電位に対応した出力(暗時出力)電圧が暗出力蓄 50 り、ブルーミング、スミア等による出力信号のばらつき

を抑えることができる。また、この実施形態10では、 ベース領域を容量結合で駆動するための電極を形成して いないため、制御領域の容量が小さくなり、高い感度を

【0164】 [実施形態11] 図14は、本発明の実施形態11による光電変換素子を示す概略構成図であり、図14(a)は光電変換素子を示す概略構成平面図、図14(b)は図14(a)のX1-X2線に沿った断面図、図14(c)は図14(a)のY1-Y2線に沿った断面図である。図14に示す光電変換素子においては、遮光膜(アルミニウム膜20)を兼用するリセット用電荷排出手段(リセットドレイン4)に接続されている金属配線を、コンタクトホール59を介して直接P型リセットドレイン領域15に接続しても良い。このような構成によって、光電変換素子の集積度を向上させることができる。

【0165】なお、上記各実施形態においては、転送制御素子31aと、リセット素子31bをMOS型電界効果トランジスタ(MOSFET)として説明したが、バイポーラトランジスタで構成しても同様の効果を得ることができる。

### [0166]

確保することができる。

【発明の効果】以上説明したとおり、本発明による光電変換素子では、増幅部の制御領域へ転送された電荷を排出するリセット用電荷排出手段と上記リセット用制御手段とを設けたため、増幅部を動作させることなくリセット動作を行うことができるという効果がある。この結果、増幅部自身に大電流が流れ、これに伴って過渡的に増幅部のバイアス点(動作点)が大きく変動して、増幅率が変わるということを抑制することができるという効 30 果もある。

【0167】また、本発明による光電変換素子では、増 幅部を電界効果トランジスタ(FET)としたため、増 幅動作時に電荷(信号電荷)が破壊されず、固定パター ンノイズ(FPN)の発生を抑制することができるとい う効果もある。さらに、本発明による光電変換素子で は、光電変換部、増幅部、転送制御部、リセット用電荷 排出手段、リセット用制御手段の各相互領域間に、予め 定められた導電型の素子分離領域を形成したため、開口 率や集積度を向上することができるという効果もある。 【0168】また、本発明による光電変換素子では、リ セット用電荷排出手段に接続される金属配線が、増幅 部、転送制御部、リセット用電荷排出手段、リセット用 制御手段への入射光を遮断する遮光膜として形成したた め、斜め入射光によるブルーミング等のにじみの現象を 抑制することができるという効果もある。また、本発明 による光電変換素子では、光電変換部に、縦型オーバー フロー構造の埋め込みフォトダイオードを用いたため、 ブルーミングやスミア等のにじみの現象を抑制すること ができるとともに、暗電流や残像、リセットノイズを抑 50

制した理想的な特性を得ることができるという効果もある。

【0169】また、本発明による光電変換素子では、光電変換素子の増幅部のチャネル形成部を半導体表面から基板内部に向かって順に、浅い第1導電型ゲート領域、浅い第2導電型チャネル領域、第1導電型半導体基板としたため、集積度や開口率を向上することができるとともに、感度を高くすることもできるという効果もある。

【0170】また、本発明による光電変換素子では、光電変換素子の増幅部のチャネル形成部を半導体表面から基板内部に向かって順に、浅い第1導電型ゲート領域、浅い第2導電型チャネル領域、第1導電型ゲート領域、第2導電型ゲート領域と、第1導電型ゲート領域とを電気的に導通したため、集積度や開口率を向上することができるとともに、感度を高くすることもできるという効果もある。

【0171】さらに、本発明による光電変換装置では、 増幅部の制御領域へ転送された電荷を排出するリセット 用電荷排出手段と上記リセット用制御手段とを設けた光 電変換素子を二次元マトリクス状に配列して構成したた め、高感度(高S/N比)で消費電力の少ない光電変換 装置を得ることができるという効果がある。また、本発 明による光電変換装置では、少なくとも1つの読出し方 向に配列された各光電変換素子のリセット用電荷排出手 段を互いに並列に配設した光電変換装置としたため、リ セット動作を高速にすることができるという効果もあ る。

【0172】また、本発明による光電変換装置では、垂直走査に応じて上記増幅部の制御領域が初期化された直後の1水平ライン分の信号出力を記憶する第1の記憶手段と、垂直走査に応じて上記増幅部の制御領域へ上記電荷を転送した直後の1水平ライン分の信号出力を記憶する第2の記憶手段とを備え、これらの記憶手段に記憶された信号出力の差を求めるようにしたため、電荷成分のみに応じた信号出力を得ることができるという効果もある。

#### 【図面の簡単な説明】

0 【図1】本発明の実施形態1による光電変換素子を示す 概略構成図である。

【図2】本発明の実施形態2による光電変換素子を示す 概略構成図である。

【図3】本発明の実施形態3による光電変換素子を示す 概略構成図である。

【図4】本発明の実施形態4による光電変換素子を示す 要部概略断面図である。

【図5】本発明の実施形態5による光電変換装置の概略 構成を示す模式回路図である。

【図6】図5に示す模式回路図の動作を説明するための

パルスタイミングチャートである。

【図7】本発明の実施形態6による光電変換素子を示す 概略構成図である。

【図8】本発明の実施形態7による光電変換装置の概略 構成を示す模式回路図である。

【図9】図8に示す模式回路図の動作を説明するための パルスタイミングチャートである。

【図10】本発明の実施形態8による光電変換素子を示 す概略構成図である。

【図11】本発明の実施形態9による光電変換装置の概 10 略構成を示す模式回路図である。

【図12】図11に示す模式回路図の動作を説明するた めのパルスタイミングチャートである。

【図13】本発明の実施形態10による光電変換素子を 示す概略構成図である。

【図14】本発明の実施形態11による光電変換素子を 示す概略構成図である。

#### 【符号の説明】

(b)

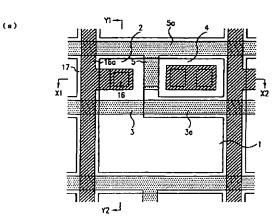
1…フォトダイオード、2…JFET、3…転送ゲー ト、4…リセットドレイン、5…リセットゲート、10 20 タ、55…コレクタ、56…ベース、57…エミッタ配 …P型シリコン基板、11…N型シリコン層、11a… S i O, 膜、12…P型フォトダイオード領域 (P型拡 \*

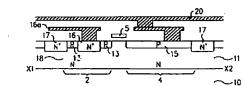
\*散層)、13…P型ゲート領域、13a…浅い第1導電 型ゲート領域、13b…第1導電型ゲート領域、14… Nウェル領域、15, 15a, 15b…P型リセットド レイン領域、16…N\*型ソース領域、17…N\*型ドレ イン領域、18…N型チャンネル領域、20…アルミニ ウム膜、21…素子分離領域、31…画素、31a…転

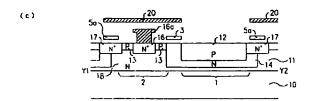
送制御素子、31b…リセット素子、31c…ドレイン 電源、32 a~32 c …垂直ソースライン、33 a~3 3c,  $35a\sim35c$ ,  $50a\sim50c$ ,  $52a\sim52$ 

c…垂直クロックライン、34…垂直走査回路、36, 37a, 51a…行ライン(共通接続線)、37, 51 …駆動パルス発生回路、38…信号出力線、38a,3 9a…バッファアンプ、39…暗出力線、40…水平走 査回路、40a~40c…水平クロックライン、41. 42, 43…駆動パルス発生回路、41a…光信号用ク ロックライン、42a…暗出力用クロックライン、44 a~44c…ソースフォロワ読み出し用定電流源、50 …ゲート電極、51…ゲート配線、52…MOSトラン ジスタ、53…バイポーラトランジスタ、54…エミッ

[図1]



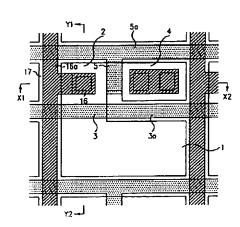


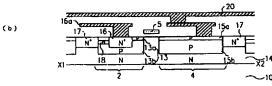


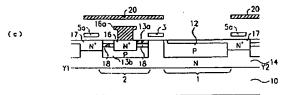
【図2】

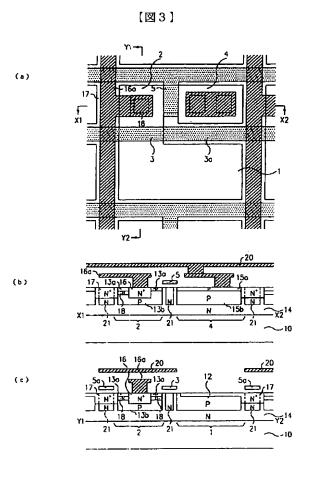
線、59…コンタクトホール。

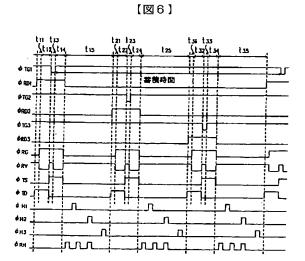
(a)

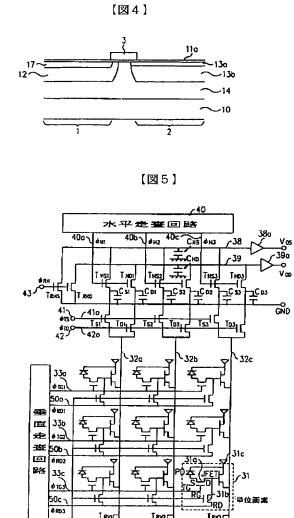


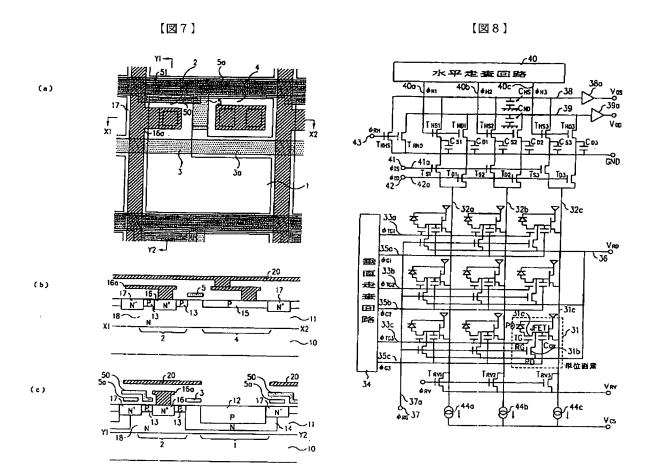












[図9]

